

La integración 3D permite aumentar la densidad de integración, sin disminuir excesivamente el tamaño de la celda. Se usa la dimensión vertical.

Disminuir excesivamente el tamaño de la celda compromete la integridad del dato almacenado, pues la carga almacenada (que sería cada vez menor) puede perderse rápidamente por corrientes de fuga. Esto afecta tanto al condensador de las DRAM como a la puerta flotante de las FLASH.

Téngase en cuenta que los chips de DRAM y FLASH lideran los límites de la ley de Moore en cuanto a densidad de integración

En la próxima década, ITRS predice la entrada en una nueva era en la Ley de Moore: "3D Power Scaling"

Caracterizada por la integración 3D y la reducción del consumo, tanto dinámico como estático

 Tendències futures Llarg termini (2020-2030) 	
* A	ctualment en fase de prototip o investigació, no comercials
	ropostes: FeRAM (Ferroelectric) PCM (Phase Change Memory) MRAM (Magnetic) STT-RAM (Spint-Transfer-Torque) ReRAM (Redox) Carbon Memory (Carbon nanotubes, graphene)

Se trata de buscar nuevas (futuras) memorias que mejoren a las DRAM y FLASH en velocidad y densidad, y que sean **no volátiles**

The "Holy Grail" of memories would be one that is faster than SRAM, of unlimited endurance like DRAM, and both dense and non-volatile like NAND Flash. In addition, The cells should be compatible with existing CMOS logic, with a low-cost manufacturing process and consume near zero power.

Actualmente se encuentran en estado de prototipos o investigación

Se han propuesto celdas basadas en nuevos mecanismos físicos y nuevos materiales: Ferroeléctrico, ferromagnético, químico,

Se trata de tener dos valores de resistencia de la celda (muy alto y muy bajo), asimilables a los dos estados lógicos '0' y '1'